

証券コード：6599

A large, semi-transparent watermark-like image of a futuristic city skyline is set against a background of a dense blue and white circuit board pattern. The city features several skyscrapers of varying heights and architectural styles, some with glowing elements. A bright, circular light source is visible on the right side of the image.

EBRAIN

個人投資家向け I Rセミナー

2021年11月27日(土)
代表取締役社長 上村 正人

- ・ 会社概要
- ・ 事業内容の説明
- ・ 2022年3月期第2四半期(第49期)決算状況
- ・ 2022年3月期(第49期)見通し
- ・ 成長への取り組み

設立	1973年（昭和48年）10月
本社	東京都八王子市石川町
資本金	1億4,301万円
売上高	32億2百万円（2021年3月期）
経常利益	3億円（同上）
従業員数	112名（2021年3月現在）
事業所	東京都八王子市、東京都荒川区、埼玉県入間市、大阪市東淀川区
子会社	蘇州エブレン（蘇州惠普聯電子有限公司：中国江蘇省蘇州市）
事業内容	産業用電子機器・工業用コンピュータの設計製造販売

通信・放送



●現在のメインの仕事内容は、

通信・電力・鉄道・医療などの「**社会インフラ系設備**」および
半導体製造装置や生産自動化機械などの「**産業インフラ系設備**」に、
コントローラーとして使用される**産業用コンピューター**の
受託設計と受託生産が中心で、売上の80%以上を占めています。

鉄道



●鉄道・電力・通信などの公共性の高い事業会社向け設備の開発や調達は、
大手の装置メーカーが主契約者となっていて、私たちのビジネスのポジションとしては、その下になります。

医療



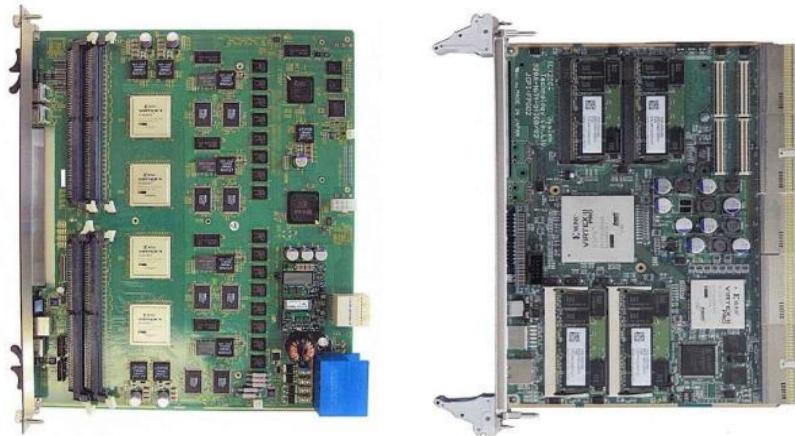
●主契約者の装置メーカーは、設備やシステムの開発構想に基づいて、
当社へ委託するコンピュータ製品の「要求仕様書」を作成して提示し、
私共はその**「要求仕様」に基づいて製品を設計**し、試作品を作つて装置
メーカーへ送り、評価と設計検証を受けます。

半導体製造装置

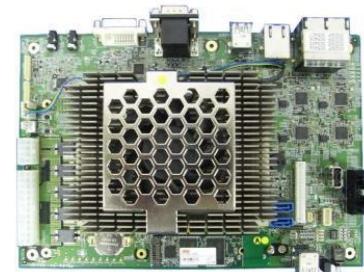


●量産に入る迄に半年とか一年以上の期間を要する事もありますが、
量産開始以降は中長期的に安定した製品供給を要求されます。

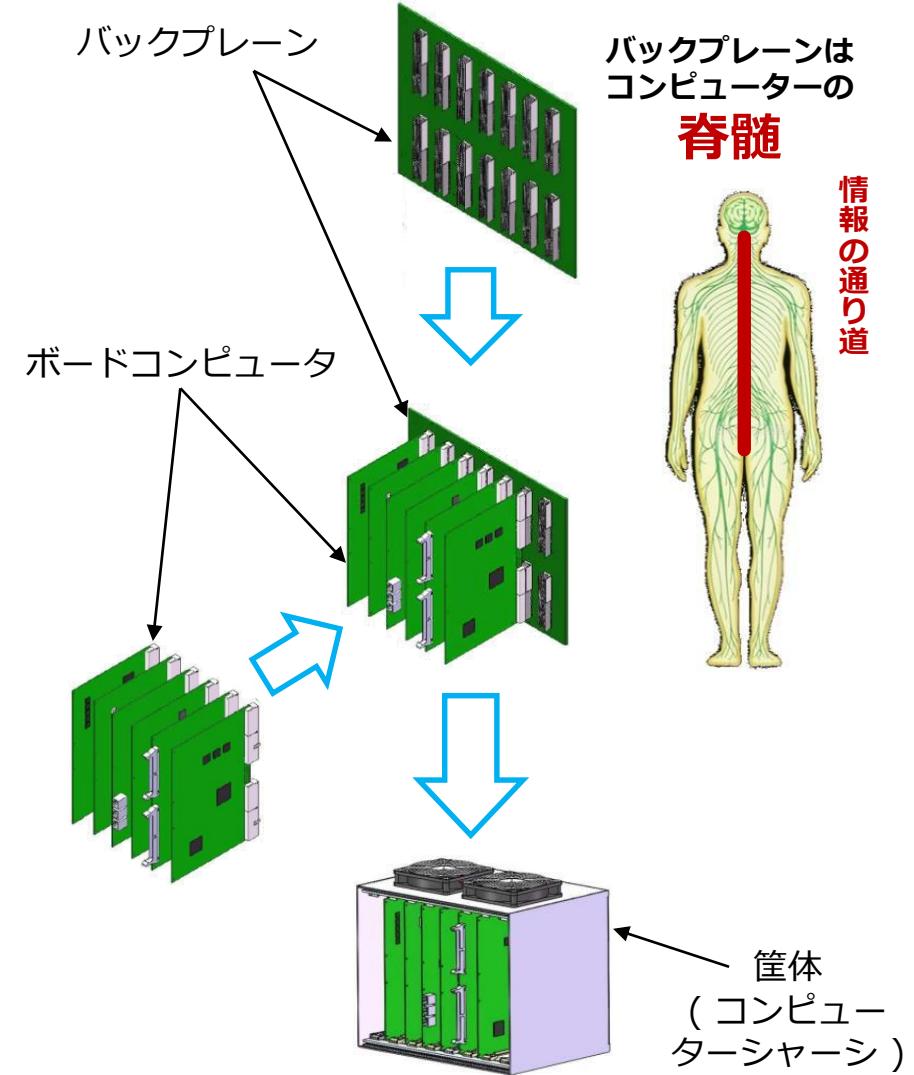
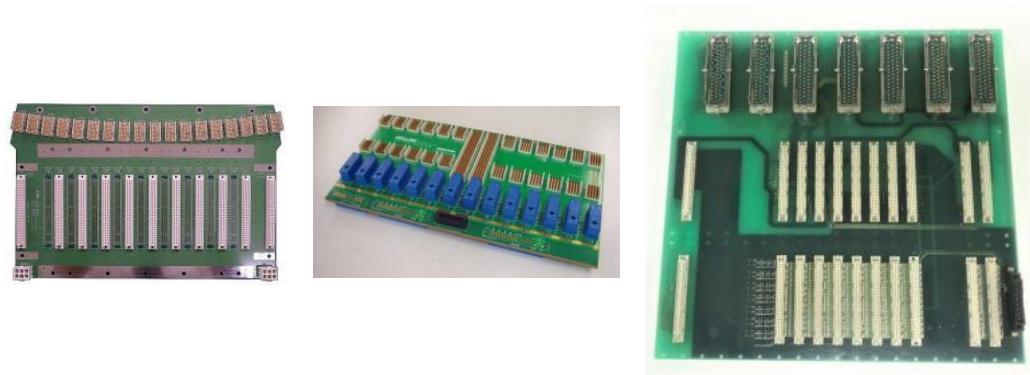
- バックプレーンシステム用
ボードコンピュータ



- IoT・Edge システム用
ワンボードコンピュータ



製品区分(2) バックプレーン



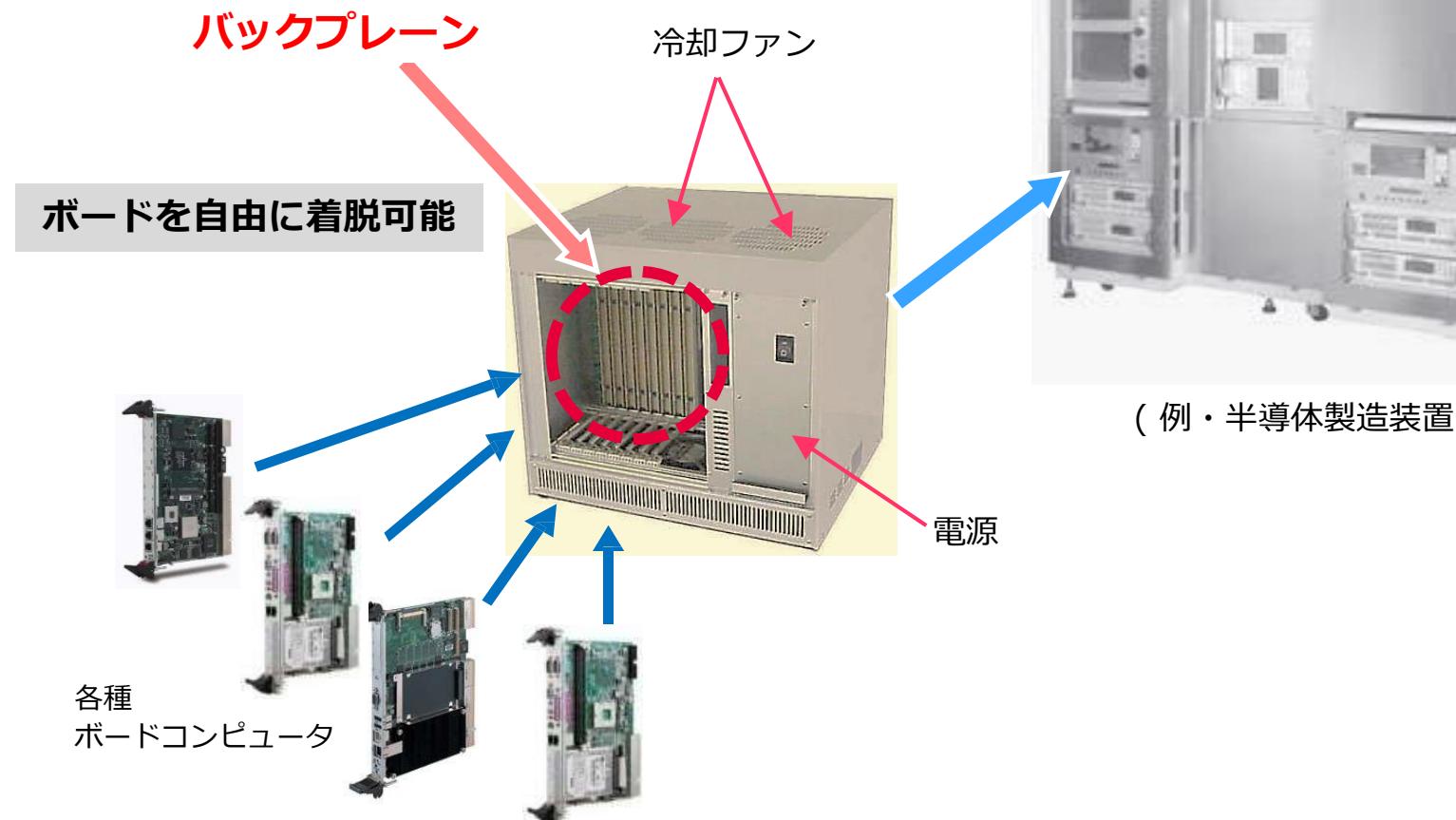
- バスラック
(バックプレーン搭載型シャーシ)



- ワンボード型シャーシ
(IoT・Edgeシステム用)



製品区分(4) 制御用コンピュータ

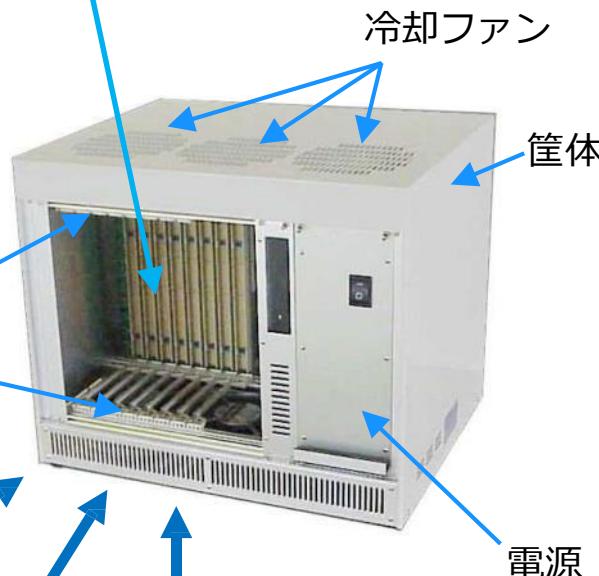


バックプレーン

【役割】
各種回路基板を相互に接続して
信号伝送や電力供給を行う



ガイドレール



ボードコンピュータ

【バックプレーン方式の利点】

ボードコンピュータが自在に着脱可能

1.保守性

ホットスワップ、
保守体制、保守要員、

2.拡張性

拡張スロット、増設、

3.汎用性

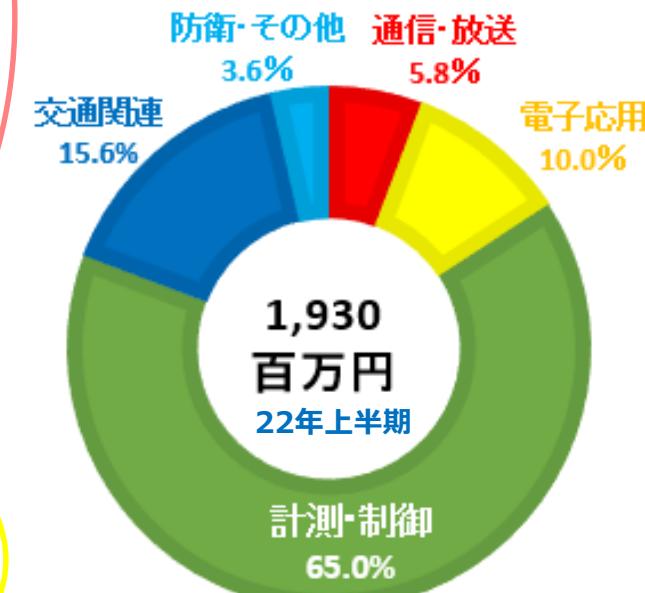
市場に流通しているボードコンピュータを採用する事が可能。

多くの産業用コンピューターで
バックプレーン方式が採用される

産業インフラ・社会インフラ関連の大手企業と安定的な取引関係を継続



連結売上高構成比
2022年3月期第2四半期



主要納入先 (直接納入,間接納入を含む)

E BRAIN エフレン株式会社

各分野の主要メーカーへ納入



NEC グループ各社



日立製作所
グループ各社



富士通グループ各社



住友電気工業（株）



GE Healthcare

GE Healthcare
グループ各社



(株) プリファード・
ネットワークス



三菱重工
グループ各社



三菱電機
グループ各社



川崎重工業
グループ各社



東京エレクトロン
グループ各社



キヤノンメディカル
システムズ（株）



古河電気工業（株）



（株）京三製作所



第一実業ビスウィル（株）



パナソニック
グループ各社



東芝 グループ各社



レーザーテック（株）



オリンパスメディカル
システムズ（株）



（株）ニコン



（株）SCREENセミコンダクター
ソリューションズ



日本信号（株）



ソニーグローバル
マニュファクチャリング &
オペレーションズ



（株）明電舎



東京計器（株）



アンリツ（株）



サムスン電子
グループ各社

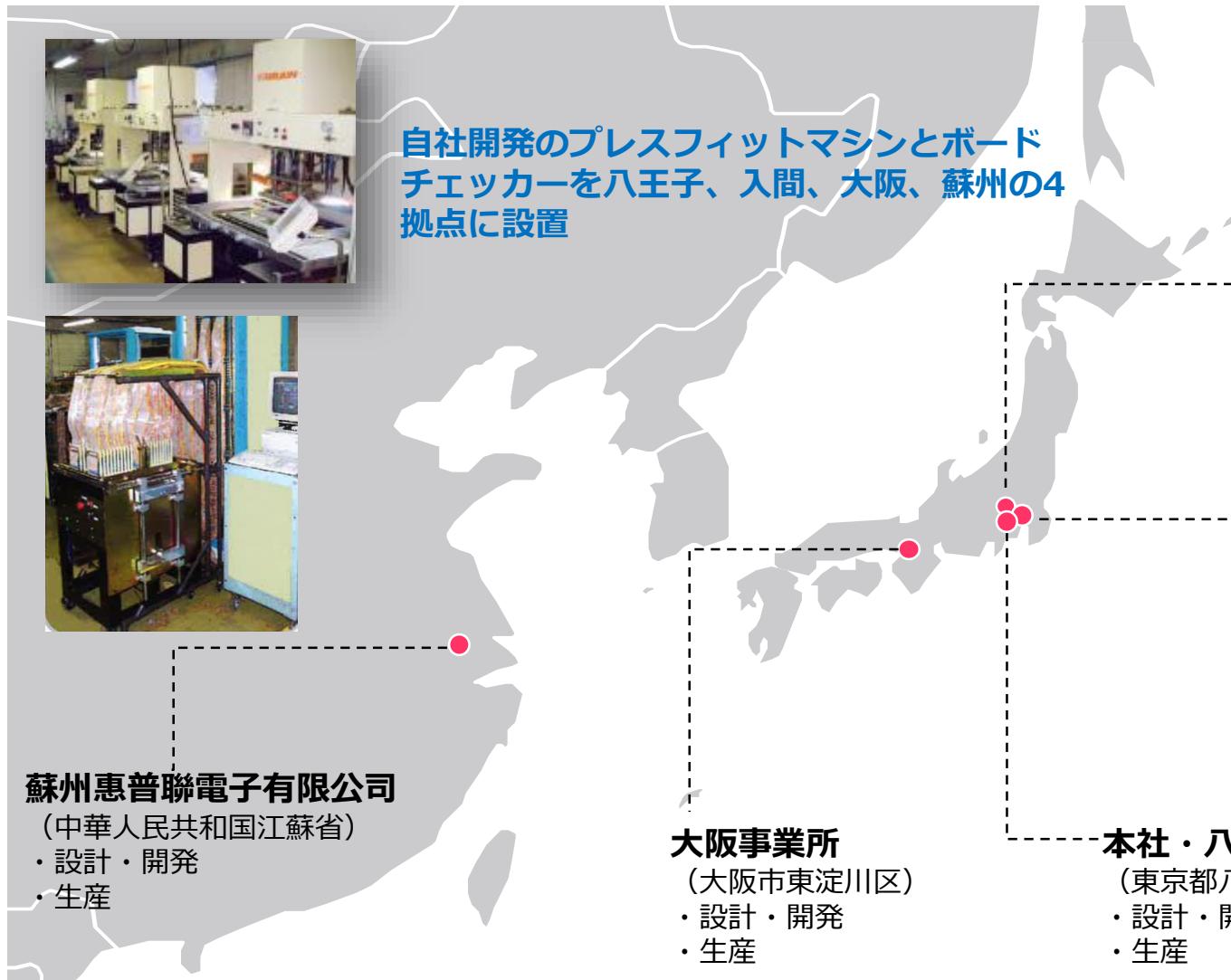


ウシオ電機（株）



（株）小野測器

BCPの観点から共通の設備で複数の生産拠点で生産



2022年3月期第2四半期 業績報告

2022年3月期第2四半期(第49期) 決算実績

EBRAIN エブレン株式会社

連結損益計算書

単位：百万円(百万円未満切捨て)

	2020.4～ 2020.9 (百万円)	2021.4～ 2021.9 (百万円)	前年同期 増減率	2022.3計画 (百万円)※	通期計画 進捗率※
売上高	1,612	1,930	+19.7%	3,449 3,765	55.9% 51.2%
営業利益	155	270	+73.6%	361 469	74.7% 57.5%
営業利益率	9.6%	13.9%		10.4% 12.4%	
経常利益	160	268	+67.5%	360 465	74.4% 57.6%
経常利益率	9.9%	13.8%		10.4% 12.3%	
当期純利益	108	176	+62.3%	239 311	73.6% 56.5%
当期純利益率	6.6%	9.1%		6.9% 8.2%	

※2022年3月期初業績予想値を見直し値に修正



計測・制御(半導体製造装置)

- ✓ 半導体の需要が引き続き堅調
- ✓ 日本製半導体製造装置の2021年度市場規模予測が大幅拡大修正
- ✓ その影響も受け、当期の売上は前年同半期比**41.0%増**となった
890百万円→1,254百万円 (364百万円↑)



交通関連

- ✓ 緊急事態宣言による移動制限の影響で鉄道会社の設備投資延期
- ✓ 海外向け鉄道関連の入札延期、設置工事遅延
- ✓ 一部の信号関連メーカーで継続して売上高増加
- ✓ 売上として前年同半期比**5.3%減**

316百万円→300百万円 (16百万↓)



通信・放送

- ✓ 電力・放送関連は例年どおり
- ✓ 通信関連はコロナの影響で設置工事や入札延期があった
- ✓ 1Gブロードバンド用光終端装置の生産終息
- ✓ 売上は前年同半期比**39.3%減**
183百万円→111百万円 (72百万円↓)



電子応用

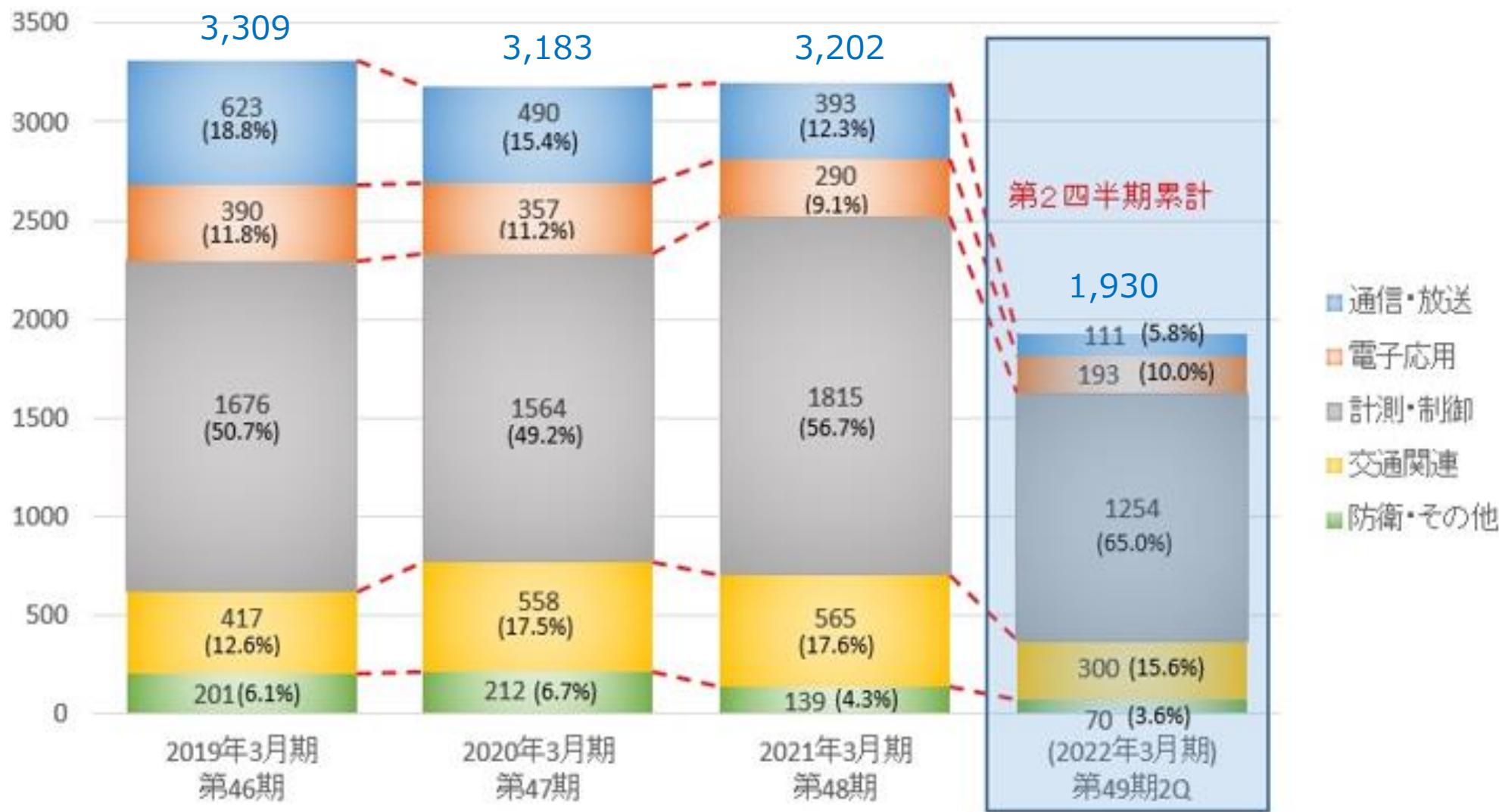
- ✓ 先送りされていた医療装置への設備投資が再開
- ✓ 売上として前年同半期比**41.3%増**
137百万円→193百万円 (56百万↑)



防衛・その他

- ✓ 売上は前年同半期比**16.2%減**
83百万円→70百万円 (13百万↓)

連結応用分野別売上推移(百万円)



2022年3月期第2四半期(第49期) 業績 - 財政状態

EBRAIN

エブレン株式会社

	2021.3 (百万円)	2021.9 (百万円)	前期末比
流動資産	3,306	3,661	+10.7%
固定資産	1,275	1,274	-0.1%
資産合計	4,582	4,935	+7.7%
流動負債	769	961	+24.9%
固定負債	364	362	-0.1%
負債合計	1,134	1,323	+16.6%
純資産	3,448	3,612	+4.7%
負債純資産合計	4,582	4,935	+7.7%
自己資本比率	75.2%	73.2%	

連結損益計算書

単位：百万円

	2021.3 (百万円)	2022.3※ (百万円)	前期比※ 増減額	前年同期※ 増減率
売上高	3,202	3,449 3,765	247 563	+7.7% +17.5%
営業利益	299	361 469	62 170	+21.0% +56.8%
営業利益率	9.3%	10.4% 12.4%		
経常利益	301	360 465	59 164	+19.8% +54.4%
経常利益率	9.4%	10.4% 12.3%		
当期純利益	200	239 311	39 111	+19.8% +55.5%
当期純利益率	6.2%	6.9% 8.2%		

※2022年3月期初業績予想値を見直し値に修正

分野によって好不調が大きく分かれる



計測・制御(半導体製造装置)

- ✓ 半導体製造装置・半導体検査装置が引き続き好調を継続する
- ✓ スマホや自動車に使用する基板向の自動化設備(チップマウンタ等)や外観検査装置も好調
- ✓ 各種IoT関連設備投資も継続
- ✓ 部品入手難顯在化リスク



交通関連

- ✓ 鉄道関連の業績悪化による、設備投資計画変更の懸念
- ✓ リニア新幹線の開業延期による影響の可能性
- ✓ 欧州向け鉄道の入札延期／停滞の可能性

分野によって好不調が大きく分かれる



通信・放送

- ✓ ブロードバンド通信機器の性能向上による設置台数減少
- ✓ 4K／8K放送対応のための更新需要継続
- ✓ 電力会社の既存設備保守や設備投資が再開



電子応用

- ✓ 国内／中国／欧州の医療機器への設備投資再開
- ✓ AI用HPC関連は前期並み

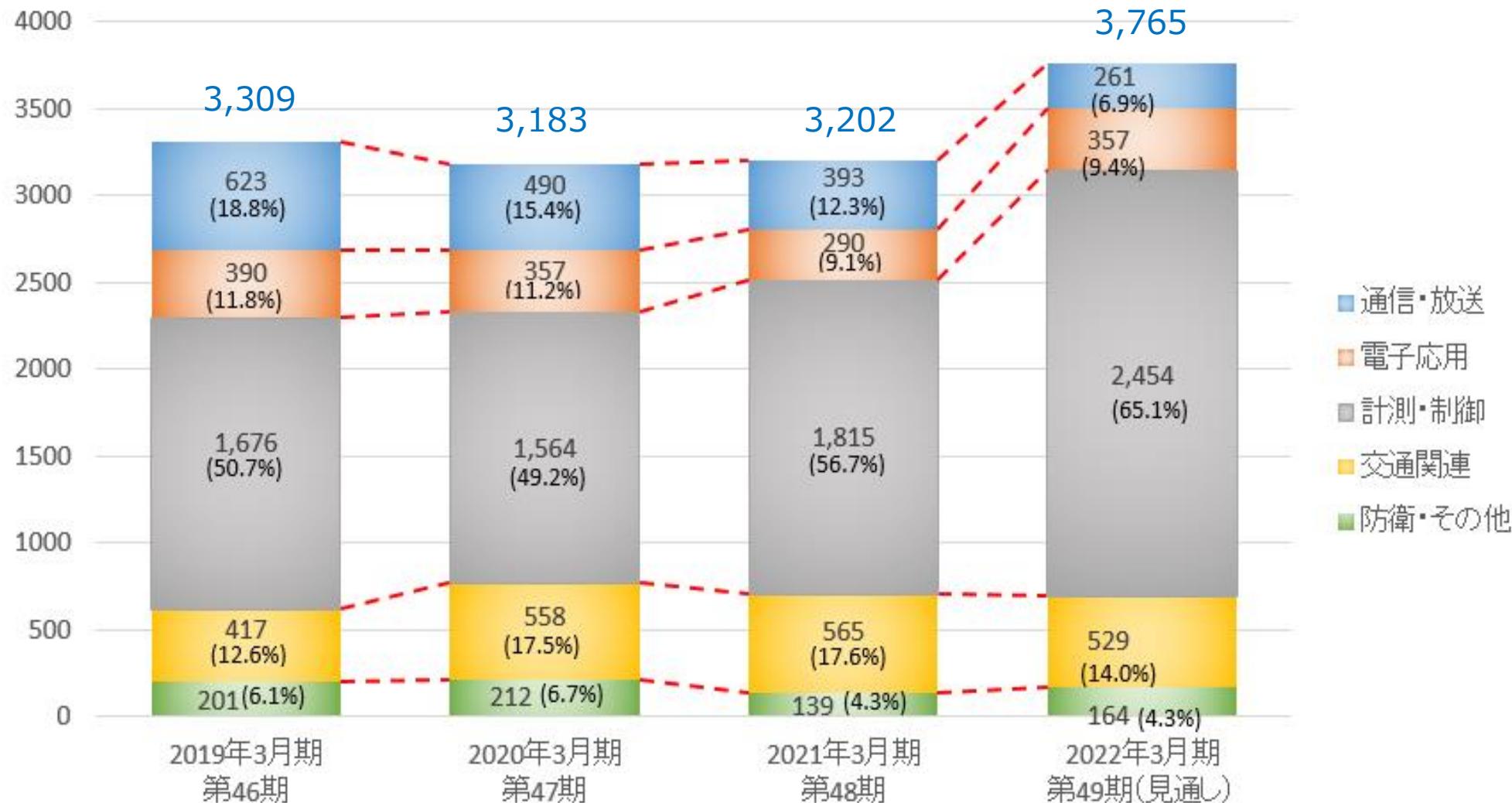


防衛・その他

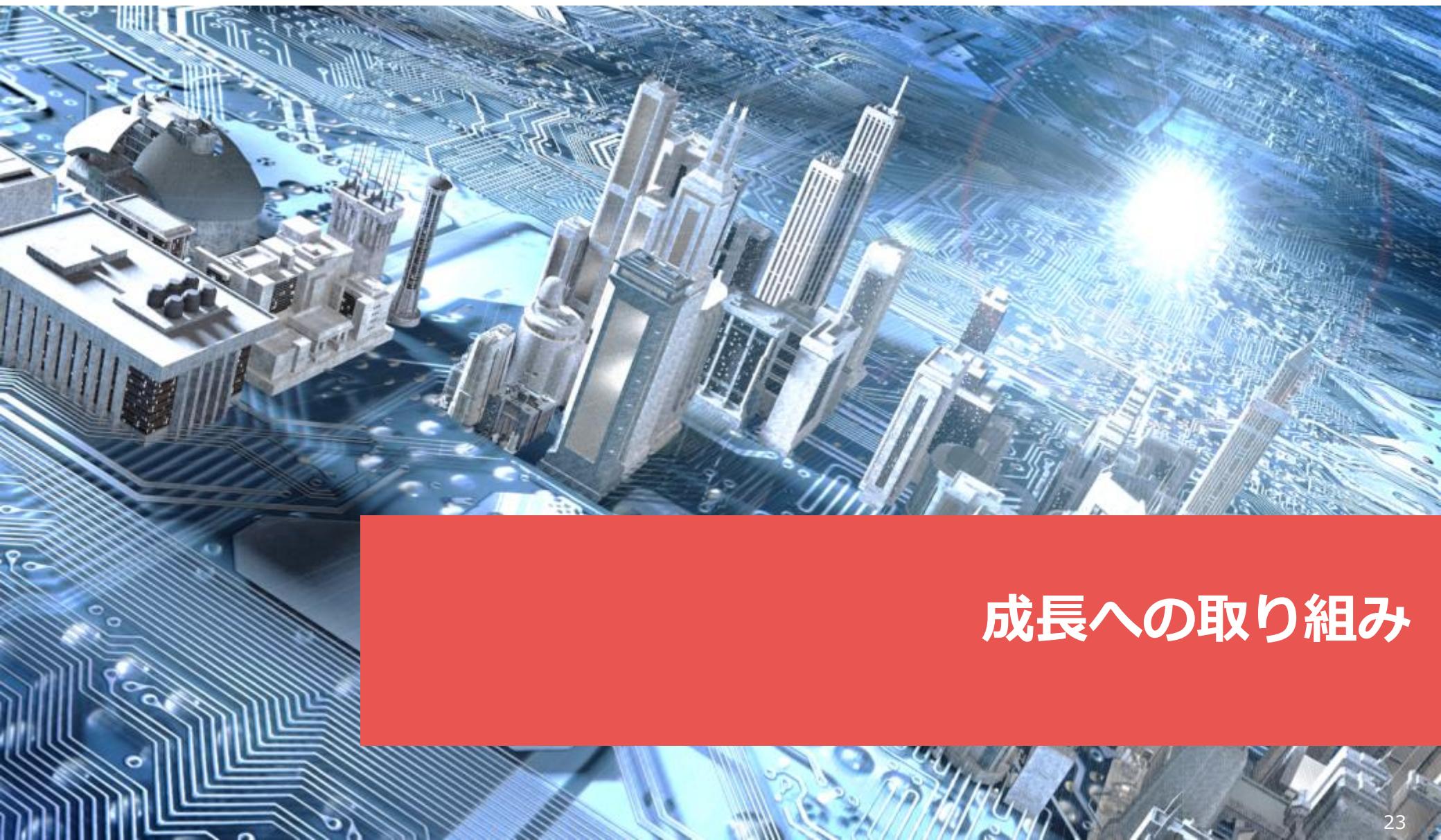
- ✓ 前期は生産前倒しによる売上減があったが、今期は通常に戻る

連結應用分野別売上推移

単位：百万円(百万円未満切四捨五入)



証券コード：6599



成長への取り組み

より価値のあるソリューションの提供を通して企業価値の拡大を目指す

(1)コア事業の強化

顧客メーカーの要求仕様に基づく、長期的安定供給を前提とした受託設計・受託生産のビジネスモデルを更に拡大します。

(2)ユニット供給の拡大

当社の顧客メーカーは、部品をバラバラで調達する事をやめ、なるべくそのまま使えるユニット(完成体)で調達したいとする傾向にあります。このようなご要求に対応すべく、製品のユニット供給体制を強化します。

(3)デジタル化、5G、IoT等への対応

今後の IoT・ローカル5G・エッジコンピューティング等を駆使したDigital Transformation (DX)関連の開発案件に対応すべく、最適なコンピュータ・ハードウェア・プラットフォームを開発します。

(4)中国子会社の戦略的活用

中国の子会社(蘇州エブレン)の戦略的活用により、中国・台湾を中心とした技術力と価格競争力のある現地調達先の開拓を推進します。

現在の売上

(1) コア事業の強化

顧客メーカーの要求仕様に基づく 受託設計・受託生産・長期的安定供給のビジネスモデルを更に拡大します。

大手システムメーカーの動向

過去

大手メーカーは設計・部材調達・生産など全てのプロセスを自社で完結していたが……

製品開発期間短縮の必要性の高まり

慢性的な技術リソース不足

技術の高度化・開発費の増大

今後

「選択と集中」が進み、ノウハウのある専業メーカーとの協業が拡大する

専業メーカーとしての 優位性を追求

(短納期・低コスト・品質向上)



コンピューターバス テクノロジーの深耕
コンピューター構造技術/生産技術の深耕
(冷却構造、耐電磁波構造 等)

システムパーツ・共通部材の拡充
(FANアラームボード、標準部材 等)

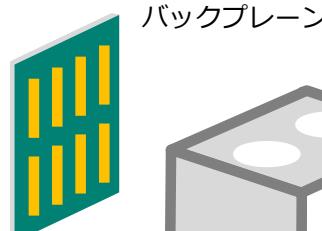
(2) ユニット供給の拡大

当社の顧客メーカーは、部品をバラバラで調達する事をやめ、なるべくそのまま使えるユニット(完成体)で調達したいとする傾向にあります。

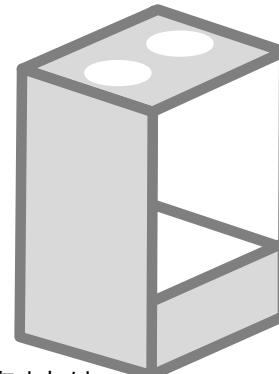
このようなご要求に対応すべく、製品のユニット供給体制を強化します。

バックプレーン・
サブラック・シャーシ

それを単体で提供

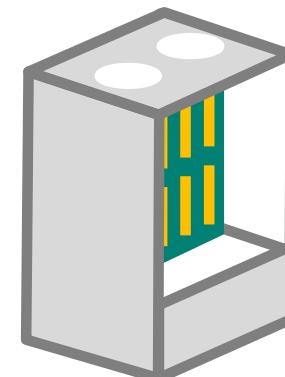


サ布拉ックまたは
シャーシ



バスラック

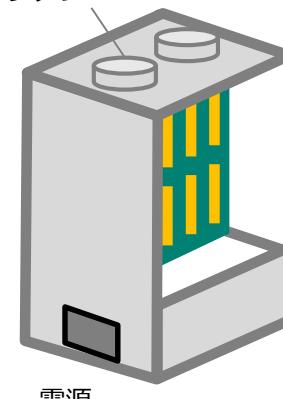
バックプレーンが組込まれた
ラック・ユニット



システムラック

バスラックに電源やファン等を
組込んで結線された
ユニット

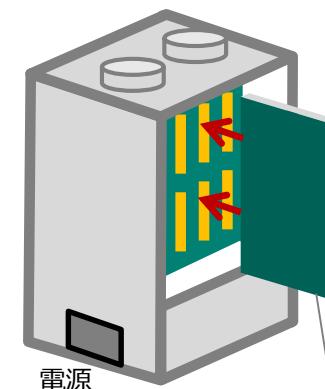
ファン



電源

コンピュータ
プラットフォーム

CPU回路を備え、ユーザー側の
目的に応じてI/Oボードやメモリー
ボードを実装して使用できる
ハードウェアプラットフォーム



CPUボード等

年々構成レベルの高い（完成品に近い）製品に対する需要が増加する傾向

お客様が本来の研究開発活動にリソースを集中していただけるよう、
お客様の多様なニーズに応えられる体制を拡充

(3) デジタル化 (DX)への対応

今後の IoT・ローカル5G・エッジコンピューティング等を駆使したDigital Transformation (DX)関連の開発案件に対応すべく、最適なコンピュータ・ハードウェア・プラットフォームを開発します。

デジタル社会を取り巻く動き

今後のデジタル化に関する様々なテーマが目白押し

クラウド/
ビッグデータ

5G/
Local 5G

Edge
Computing

AI

スパコン/
HPC

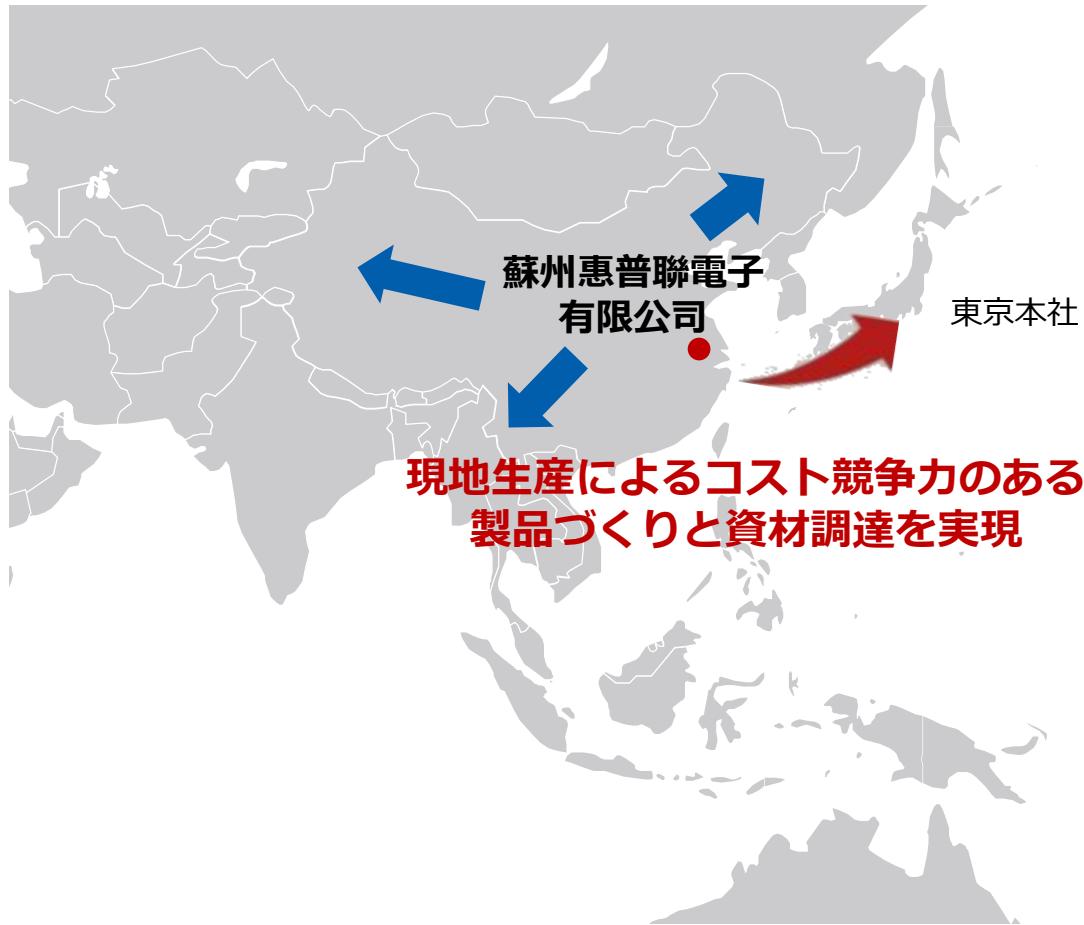
IoT

これらの分野にはすべて
それぞれの目的に叶ったコンピューターが不可欠

ユーザーの要求を満たす最適なコンピュータープラットフォームを提供

(4) 中国子会社の活用強化

中国の子会社(蘇州エブレン)の戦略的活用により、
中国・台湾を中心とした技術力と価格競争力のある現地の部材調達先の開拓を推進します。
現地企業および日系の進出企業へ現地生産によるコスト競争力のある製品を提供します。



蘇州惠普聯電子有限公司
概要

会社名	蘇州惠普聯電子有限公司
本社所在地	中華人民共和国江蘇省蘇州市
創業開始	2002年9月
資本金	82百万円
株主構成	当社100%
事業内容	バックプレーン及びバスラック等の製造販売及び輸出入、部材の現地生産調達先の開拓

本資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、確信等は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因にかかる仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって予測数値とは異なる可能性があるため、本資料のみに全面的に依拠することは控えていただきますようお願い申し上げます。

また、本資料は投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、ご自身のご判断において行われますようお願い申し上げます。

ご清聴ありがとうございました。

EBRAIN